

上海润欣科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

一、2021 年度公司经营情况

公司自成立以来一直专注于无线通信 IC、射频 IC 和传感器件的分销、应用设计及技术创新，是国内领先的 IC 产品和 IC 解决方案提供商。目前公司主要的 IC 供应商有高通、思佳讯、AVX/京瓷、安世半导体、瑞声科技、恒玄科技等，拥有美的集团、闻泰科技、大疆创新等客户，是 IC 产业链中连接上下游的重要纽带。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

近年来，随着物联网、智慧家居、新能源汽车等新兴市场的崛起，集成电路设计需要融合无线通讯、功率器件、存储、传感等多种功能，应用于门类繁多的智能物联网(AIOT)应用场景。针对本土细分市场及重点客户，定制开发专用化的芯片和模块，逐渐成为国产半导体行业自主发展的必由之路。

报告期内，公司充分发挥了客户资源、供应商资源与研发体系的协同效应，通过自研+产业合作的方式拓展新的市场，在智慧家居、智能穿戴、汽车电子等领域的新业务增长明显。2021 年度，公司实现营业总收入 18.58 亿元，较上年同期增长 33.96%；归属于上市公司股东的净利润为 5,824.73 万元，较上年同期增长 29.37%；扣除非经常性损益后的净利润为 5,777.77 万元，较上年同期增长 26.57%。报告期内，公司在数字通讯芯片及物联网领域的业务同比增长 100%，芯片方案的研发设计能力和持续盈利能力得到了显著的提升。

报告期内，公司研发设计了两颗具有自主知识产权的温度传感和多功能遥控器芯片，带 LCD 显示的温度传感芯片已于 2021 年 5 月份批量生产，主要针对蓝牙体温计、温度标签市场。另一颗应用于智能家居的多功能遥控器芯片，目前处于工程样品流片和测试阶段。

报告期内，公司利用多年来在无线连接、射频、传感领域的技术和客户积累，与上游半导体设计公司合作，为重点客户定制了 IOT 智能家电无线芯片、智能照明专用模块，目前定制芯片和智能照明模块均已量产，并顺利通过了客户产品、技术和质量部门的测试，投入批量生产。2021 年，公司“定制和自研芯片”产

品共计实现销售额 1,470.28 万元，标志着公司向半导体芯片定制设计和国产化替代迈出了坚实的一步。

在 TWS 耳机、智能手表芯片方案和研发项目上，公司与高通、瑞声科技、恒玄科技等核心供应商紧密合作，在向客户销售 TWS 耳机芯片方案的同时，扩展了 SIP 微型发声模块的定制设计和加工生产能力。

在报告期内，公司积极应对国内半导体市场的供需失衡和供应短缺，配合通讯模块、安路科技 FPGA 产品线，与 LED 驱动芯片设计厂商合作，垂直整合 LED 驱动芯片设计、智能商显屏控制卡，提供 EDA 综合工具、光罩、晶圆代工配额、晶圆 CP 测试等系列服务，保障芯片供应产能，提升公司主营业务的核心竞争力。

此外，公司在主营业务和产业布局上新增了微能量收集、超低功耗蓝牙芯片、远红外监测等产品线，提高了公司在半导体应用设计领域的拓展能力，且为公司带来了汽车电子、安防、新零售和智能家居市场的优质客户资源。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议内容

2021 年度，公司董事会共召开了八次会议，具体情况如下：

序号	会议名称	会议时间	会议议案
1	第三届董事会第十八次会议	2021 年 1 月 15 日	(1)《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 (2)《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 (3)《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 (4)《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
2	第三届董事会第十九次会议	2021 年 1 月 27 日	(1)《关于公司全资子公司润芯投资通过增资方式引入投资者暨关联交易的议案》 (2)《关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》 (3)《关于公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》
3	第三届董事会第二十次会议	2021 年 2 月 3 日	(1)《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 (2)《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 (3)《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

4	第三届董事会第二十一 次会议	2021年4 月21日	<p>(1)《关于2020年年度报告及其摘要的议案》</p> <p>(2)《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》</p> <p>(3)《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》</p> <p>(4)《关于<2020年度财务决算报告>的议案》</p> <p>(5)《关于<2020年度利润分配预案>的议案》</p> <p>(6)《关于<2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》</p> <p>(7)《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》</p> <p>(8)《关于2020年度审计报告的议案》</p> <p>(9)《关于续聘2021年度审计机构的议案》</p> <p>(10)《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>(11)《关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》</p> <p>(12)《关于会计政策变更的议案》</p> <p>(13)《关于2020年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》</p> <p>(14)《关于开展外汇套期保值业务的议案》</p> <p>(15)《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》</p> <p>(16)《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》</p> <p>(17)《关于延长公司向特定对象发行股票方案股东大会决议有效期的议案》</p> <p>(18)《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》</p> <p>(19)《关于向控股子公司润芯投资提供财务资助及向关联方借款暨关联交易的议案》</p> <p>(20)《关于孙公司与关联方共同对外投资设立控股公司暨关联交易的议案》</p> <p>(21)《关于公司<子公司管理制度>的议案》</p> <p>(22)《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》</p> <p>(23)《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》</p> <p>(24)《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>(25)《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>(26)《关于召开2020年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》</p>
5	第三届董事会第二十二 次会议	2021年4 月27日	<p>(1)《关于<2021年第一季度报告>的议案》</p>
6	第四届董事会第一 次会议	2021年5 月18日	<p>(1)《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》</p> <p>(2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》</p> <p>(3)《关于选举公司第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》</p> <p>(4)《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p>

7	第四届董事会第二次会议	2021年8月2日	(1)《关于2021年半年度报告及其摘要的议案》 (2)《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
8	第四届董事会第三次会议	2021年10月27日	(1)《关于<2021年第三季度报告>的议案》

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

本年度内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

三、公司未来发展的展望

2020年初出现的新冠疫情给全球化宏观经济形势带来超预期波动，欧亚的地缘政治冲突也对全球的半导体集成电路产业链的稳定供应产生了深远影响，电子加工业的全球化布局和实时生产结构将面临挑战，中国本土的半导体集成电路产业和电子加工供应链会长期处于结构性的供需失衡。

1、顺应半导体集成电路产业周期，由“全球供给驱动”向“本地市场需求和特色工艺驱动”的转变

追溯到集成电路源头的晶圆生产，投资最先进制程，为众多的 Fabless 设计公司提供领先的生产工艺和技术能力是全球晶圆代工厂发展的基石。半导体工艺技术节点进入到 7nm 以后，近三年来，以 UMC、格罗方德为代表的主力晶圆代工厂相继退出了先进制程的投资布局，而大陆的中芯国际等晶圆代工厂受到西方技术禁售的影响，也放慢了追赶的脚步。全球先进制程的引领者台积电、Intel 和三星开始实现半导体工艺节点上的领先和垄断。更多的 Fabless 芯片设计公司把业务重点投向模拟芯片、低功耗无线 MCU 芯片、传感、分立器件等产品，这些领域对芯片制程先进性要求较低，带有特色工艺的 6 英寸、8 英寸和 12 英寸晶圆产品线均有各自优势的细分市场和应用环境。为顺应市场变化，公司规划增加功率器件、分立器件、传感器芯片在公司业务中的占比，增加晶圆代工分销服务和模数芯片设计业务，整合中国大陆和台湾带有特色工艺的晶圆代工厂产能，提供包括 EDA 综合工具、光罩、晶圆 CP 测试、芯片自研设计在内的系列服务，保障在优势领域的无线芯片、功率器件和 MEMS 传感器的本地供应，提

升公司主营业务的核心竞争力。

2、加速数字化转型，为行业重点客户提供芯片定制设计服务和应用解决方案

据统计，新冠疫情爆发以来，79%的半导体公司采取措施减少商务旅行，增加数字工作环境，削减研发成本，使得数字化程度较高的半导体公司变得高效且更具灵活性，在过去的两年获得盈利的高速增长。与此同时，疫情驱使商业和消费市场的客户改变过去实时采购库存的做法，转向定制设计、提前下单定购关键元器件。

公司计划充分发挥自身在优势客户渠道与半导体供应链资源的高契合度和协同效应，以客户为中心，通过自研+产业合作的方式拓展智能家电、汽车电子、智能穿戴等新领域市场，为客户提供芯片定制服务和应用解决方案。在智慧家居领域，公司利用多年来在无线连接、射频、传感领域的技术积累，与上游半导体设计公司合作，为重点客户定制了 IOT 智能家电无线芯片、智能照明专用模块。

预计在今后三年，芯片定制设计和自研芯片、器件的销售收入将占到公司主营业务的三成；客户芯片的定制化设计和无线物联网芯片的国产化替代是公司长期的发展策略。

3、专注本业，增加产业投资，成为国内在绿色低碳、低功耗 IOT 芯片领域的领先者

多年来，润欣科技一直专注于无线连接芯片和传感技术的应用，无线 IOT 传感网络、超低功耗无线芯片、智能声学、视觉等的 MEMS 传感技术是公司未来长期规划的领域。在无法运用能量采集技术的情况下，全球大约有 90% 的无线传感器网络的实用性远未达到设计要求，嵌入在数以十亿计的建筑、物流、农林业、畜牧业中的无线传感网络，难以为大量的网格节点更换电池。医疗健康行业所需的智能穿戴和体内仿生传感器，主要针对老年人和病人的监护，免电池维护也是未来大量生物医药工程研究中的焦点。随着微能量收集技术和超低功耗无线芯片技术的发展，高精度、随处布放、无需供电的物联网设备将摒弃复杂的工程布线和电池更换，利用收集微弱的环境能量供电，维持数据采集电能自给自足，改变环境监测、新零售、安防、农业养殖等领域的运作方式，真正实现无处不在、万物互联。

公司计划依靠多年积累的客户、研发和技术资源，进一步增加产业投资，整合无线芯片设计、微能量收集、传感和功率芯片设计、测试等环节，打造领先的

软硬件一体化产业平台，成为国内在绿色低碳、低功耗无线芯片和智能传感网络市场的技术领先者。

润欣科技的核心优势是专注、专业化，公司有信心在未来继续维持良性的增长，公司将秉承“专注、专业化、差异化”的理念，为客户创造价值，为员工提供稳定开放的工作环境，为股东和社会创造效益。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2022年4月25日